

拓荆科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，于 2024 年 4 月制定了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。通过切实实践“提质增效重回报”行动方案，公司在持续优化公司经营、增强投资者回报、加快创新发展、强化投资者沟通、规范公司治理等方面取得了良好成效。为进一步提高公司发展质量，切实关注投资者回报，公司特制定了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，在总结 2024 年度行动方案成效的基础上，积极深入挖掘公司“提质增效”创新路径和举措，助力资本市场健康、稳定发展。公司 2024 年度行动方案的执行情况和 2025 年行动方案包括以下方面：

一、聚焦主业，优化运营，创新引领公司高质量发展

2024 年度，公司继续聚焦主业，做深做精主营产品，坚持自主创新，增强公司产品的市场竞争力，并持续强化公司运营管理，促进公司高质量、稳健、快速的发展，保持公司在国内高端半导体设备行业的领先地位。具体包括以下方面：

（一）持续深耕主业，提高核心竞争力

2024 年度，公司面向国内芯片制造技术的迭代创新和下游客户快速发展的需求，继续在高端半导体设备领域深耕，不断提升 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备及三维集成领域设备（包括先进键合设备和配套量检测设备）的应用覆盖面及量产规模。2024 年，公司自主研发并推出了 10 余款新产品/新工艺设备，包括 Flowable CVD、PECVD Bianca、PECVD Supra-D Stack（ONO 叠层）、ACHM、ALD SiCO、SiN 等薄膜沉积设备，以及应用于三维集成领域的晶圆对晶圆熔融键合设备、芯片对晶圆混合键合设备、键合套准精度量测设备和键合强度检测设备，且大部分新产品/新工艺已在逻辑芯片、存储芯片、三维集成等领域实现产业化应用。

公司推出的新型设备平台（PF-300T Plus 和 PF-300M）和新型反应腔（pX 和 Supra-D）均取得了良好成效，2024 年实现大批量出货并陆续通过客户验证，满足不同客户在技术更新迭代过程中对高产能、高性能等多样化需求。同时，公司开发了更高产能的设备平台 NF-300M 及反应腔 Supra-H，可以实现高均匀性和多种薄膜工艺集成，满足先进存储芯片制造领域最先进的生产需求，2024 年完成了样机研发。公司另开发了具有业界领先的坪效比和最低的拥有成本(COO)的新平台 VS-300T，在满足客户高性能需求的同时，为客户节约成本。

为实现产品系统性能的进一步提升，2024 年，公司开发了一套智能化的软硬件系统（Smart Machine），通过引入数据统计、方差分析、机器学习等方法，搭建了智能化数据分析平台。该平台对量产设备的海量数据实时收集并进行高效分析，促进设备性能和维护效率的提升，以及研发成本、维护成本的降低，进一步提高产品竞争力。

这些突破性成果保持了公司产品市场竞争优势，并为公司带来新的业务增长点。2024 年度，公司设备反应腔出货超过 1,000 个，同比增长超过了 110%，截至报告期末，公司累计出货超过 2,500 个反应腔。报告期内，公司实现营业收入 41.03 亿元，同比增长 51.70%。

2025 年，公司将继续聚焦高端半导体领域，持续关注半导体行业发展趋势和下游晶圆厂对设备的先进需求，充分发挥技术优势，加快新产品/新工艺推出，预计 2025 年将有超过 10 款新产品/新工艺出货或通过客户验证，进一步拓展薄膜沉积设备和三维集成领域设备的应用覆盖面及量产规模。同时，通过持续优化设备平台及反应腔等关键部件设计，不断提高设备产能和性能，通过引入大语言模型技术完善优化智能化软硬件系统（Smart Machine），进一步强化公司主营产品市场竞争力。

（二）深化客户合作，加强市场拓展

2024 年度，公司继续聚焦中国大陆高端半导体设备市场，积极响应下游客户对新工艺、新产品的需求，加快产品开发与导入，并以良好的稳定性、高产能及优异的薄膜工艺指标等特点持续保持产品的竞争优势，高效提升了产品覆盖面和量产应用规模。2024 年，公司薄膜沉积设备和三维集成领域设备实现了多个

新客户拓展，获得客户的大量订单。截至 2024 年末，公司在手订单金额约为 94 亿元，公司产品已进入超过 70 条生产线。

2025 年，公司与客户继续保持深入稳定的、战略性的合作，根据客户不同需求，高效提供定制化、高性能的设备产品，并加大力度推进新产品验证，新签订单持续增长。同时，公司深入了解行业前沿需求，积极布局三维集成领域的设备产品，致力于为三维集成领域提供全面的技术解决方案，为公司业务的持续高速增长及进一步巩固市场地位奠定坚实基础。

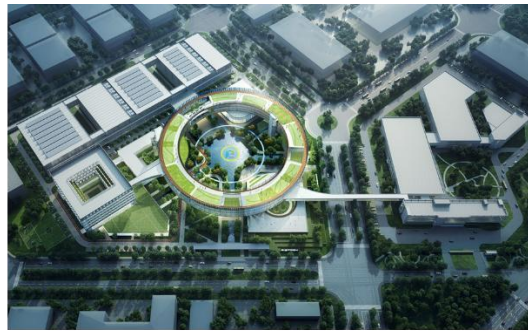
（三）加快募投项目推进，持续扩建产能

2024 年度，公司首次公开发行股票募投项目“先进半导体设备的技术研发与改进项目”、“ALD 设备研发与产业化项目”两个项目均已按期实施完成并结项。基于“ALD 设备研发与产业化项目”建成的上海临港研发与产业化基地（上海一厂）已投入使用，提升了公司先进薄膜沉积设备的产能支撑能力。

此外，截至本报告披露日，公司超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”（上海二厂）已完成基地的整体建设，预计 2025 年 6 月前投入使用；新建募投项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”（沈阳二厂）按计划顺利推进，公司已取得土地使用权证、用地规划许可证和工程规划许可证。



上海二厂
（超募项目：建设中，效果图）



沈阳二厂
（新建募投项目：规划中，效果图）

2025 年，公司超募资金投资项目（上海二厂）预计结项并投入使用，将大幅提高公司产能支撑能力，该项目预计募集资金使用率不低于 80%；同时，公司将全力推进新建募投项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”（沈阳二厂）建设工作。

（四）优化运营管理，助力高质量发展

2024 年度，公司持续推行精益生产，搭建的智能化 MES（生产管理系统）全面上线运行，实现生产过程、质量状态、资源情况的实时监控与透明化管理，有效提升生产效率和生产质量，确保产品按时交付。2024 年，公司正式启动“全面质量管理年”，深化产品质量管理体系，公司及相关子公司获得了 ISO 9001 认证，严格遵循国际质量管理标准，以更系统、精细的管理模式适应半导体设备行业的发展趋势，确保产品的高性能、高可靠性及高安全性，持续提升公司市场竞争力。此外，公司持续完善安全管理体系，促进企业的安全环保管理和文化建设，不断加强安全风险隐患的排查及防治，为公司安全、合规生产提供有力保障。

2025 年，公司将深入贯彻质量管理理念，持续推进质量优化与技术创新，以产品质量赢得客户的高度认可。同时，不断加强风险防控，促进合规、高效运营，促进公司社会责任的履行。

（五）强化供应链建设，保障供应链稳定安全

2024 年度，公司持续加强供应链建设，采取多元化的供应策略，建立多区域、多层级的供应商网络。在与国际行业内知名供应商合作的同时，也与国内众多优质供应商建立紧密合作关系，构建了兼顾本地特色与多元布局的稳健供应链体系。公司持续拓宽、加深与供应商的协同合作，通过推动供应商建立本地仓储，缩短交货周期，同时，通过开展质量、技术等系列培训，全面提升供应商质量意识，并深入理解公司新产品和新技术需求，促进供应商产品质量与产品性能的不断提升，确保供应部件的交付质量。2024 年，公司开展供应商培训和现场稽核共 100 次，并荣获了中国集成电路创新联盟颁发的第八届“IC 创新奖”产业链合作奖。

2025 年，面对半导体设备产业高度复杂的供应链挑战，公司将严格遵守国际出口管制相关法规，确保供应链合规性，并持续完善多元化供应商体系、战略库存与弹性备货机制、创新保障与协同研发等多维度的保障措施，确保供应链安全与运营连续性，同时推行绿色供应链管理。

（六）加强人才队伍建设，夯实公司高质量发展根基

2024 年度，公司持续加强人才梯队建设，引进行业经验丰富的管理及技术人才，并从国内高校选拔优秀的毕业生，人员规模不断扩大。截至 2024 年 12 月 31 日，公司员工总数 1,532 人。

在人才培养方面，公司积极组织管理、专业技术、通用力等系列培训，不断提升中层干部的管理能力和管理水平，强化员工的专业技能和基础能力，此外，公司持续加大力度支持员工在职教育，并与高校共同联合培养博士后。2024 年，公司累计开展技术类、管理、通用力等培训超过 200 次，共对 9 名员工提出的在职攻读 MBA（工商管理硕士）、在职研究生和博士学位的申请予以支持。

2025 年，公司将继续完善人才梯队建设，通过提供具有竞争力的薪酬福利、长效的激励机制及良好的发展平台吸引人才，为公司发展输送强劲动力，预计 2025 年人员总规模将进一步扩大。同时，公司将持续优化多层次的人才发展体系，包括开展多元化培训项目、继续鼓励员工在职深造、公平透明的晋升机制等，全面提升公司人才队伍的整体素质，致力于打造一支高素质、富有创新精神和协作能力的人才队伍，夯实公司高质量发展根基。

（七）优化管理层与全员绩效考核，保障公司稳定发展

2024 年度，公司对管理层和全员设定了年度系列经营指标，覆盖公司销售业绩、盈利目标、新工艺和新产品开发验证等，有效的将管理层绩效与公司经营业绩挂钩。此外，根据公司的长效激励机制，公司完成了 2023 年限制性股票计划的首次授予和预留授予，其中，首次授予共向 697 名激励对象授予 444 万股（公司 2023 年年度资本公积转增股本后股数）第二类限制性股票，预留授予共向 214 名激励对象授予 111 万股限制性股票，进一步增强公司股权激励的效果。

2025 年，公司实施了 2025 年限制性股票激励计划，将股份回购的 126.7894 万股用于股权激励授予，并设定了持续增长的公司业绩考核指标及激励对象个人绩效指标。此外，公司将继续完善管理层及员工的绩效管理体系，并继续稳步执行各期股权激励计划，在满足公司绩效指标和个人绩效指标的情况下，使员工充分享受到与公司共同发展的成果，保障公司稳定发展。

（八）搭建产业投资平台，拓展业务布局

2024 年度，公司结合发展战略规划，进一步完善业务发展布局，在日本和 BVI（英属维尔京群岛）成立了全资子公司，为公司进一步拓展海外市场奠定基础。同时，公司积极开展产业链投资布局，2024 年，公司及全资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称“岩泉科技”）参股投资了 9 家上游供应链企业，进一步促进产业链协同发展。此外，岩泉科技与其他投资方共同发起设立了上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙），该基金专注于半导体设备零部件产业链领域的股权投资，充分发挥公司的产业链主引领作用及其他投资方的产金融合优势，紧密围绕半导体产业链上游环节，助推我国半导体设备及零部件产业做大做强。

2025 年，公司将继续拓展产业布局：（1）设立了控股子公司拓荆科技（青岛）有限公司、拟与沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会及其他产业合作方共同发起设立辽宁省集成电路装备及零部件创新中心（筹），均是围绕半导体产业发展趋势布局前沿技术；（2）依托自身产业资源优势及链主基金平台，继续探索产业链投资机会，积极助力国内产业链企业的创新发展；（3）进一步寻找合适的市场机遇，积极探索并拓展海外市场。

（九）深化产学研融合，促进行业共同发展

公司秉持校企协同发展理念，与清华大学、复旦大学、大连理工大学等高校合作互动，通过共建产学研协同创新平台、实验室项目合作、设立“拓荆奖学金”、多学科联合培养硕士/博士等方式，推动高端科研合作及专业人才储备，为行业提供创新动力。2024 年有 3 名博士在公司与高校合作的博士后工作站学习深造。

2024 年，公司参加了 SEMICON China、中国半导体设备年会及湾芯展 SEMiBAY 等行业展会及论坛，携公司薄膜沉积设备及三维集成领域设备新产品亮相展会，向行业同仁分享最新成果，获得了广泛关注与赞誉，同时，公司团队与行业专家、合作伙伴们开展了深入交流与探讨，力争共同促进半导体行业的创新与发展。

2025年，公司将继续深化产学研融合，通过项目技术合作、持续提供“拓荆奖学金”等方式，加强与高校的合作维度和深度。公司将继续积极推动行业联动与交流合作，通过深度参与国际半导体展会及行业大会，共同探讨前沿趋势，携手推动产业协同创新。

（十）强化财务管理能力，真实、公允反映公司财务状况

公司高度重视财务绩效管理对公司战略发展的作用，不断提高公司盈利能力；公司已建立完善的预算体系，通过预算的编制、执行和监控，能够实现高效的资源配置，合理的控制成本；通过合理有效运用各种融资工具，优化资本结构，降低资金成本，增强财务灵活性，保障资金链安全；通过加强应收账款的管理，降低坏账风险，提高公司的运营效率。

二、坚持自主创新，驱动业务发展

（一）保持高强度研发投入，持续技术创新

公司一直坚持自主创新，并保持较高水平的研发投入，2024年公司研发投入金额达到7.56亿元，同比增长31.26%。公司通过高强度的研发投入，保持细分领域内产品技术领先，同时，不断丰富薄膜沉积设备及应用于三维集成领域设备产品的品类，拓宽工艺应用覆盖面，在新产品和新型平台研发、验证，及产业化应用等方面均取得了突破性成果，详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2025年，公司将继续保持较高水平的研发投入，持续加快新产品/新工艺推出，预计超过10款新产品/新工艺出货或通过客户验证，进一步拓展薄膜沉积设备和三维集成领域设备的应用覆盖面及量产规模，主要新产品/新工艺拓展计划如下：

产品类别	2025年主要新产品/新工艺拓展计划
PECVD系列产品	1. 完成新型高产能反应腔研发，基于该反应腔开发的工艺设备出货； 2. 基于现有新型反应腔（Supra-D、pX等）完成多款新工

	艺产品的开发/优化，并通过客户验证。
ALD 系列产品	1. 推进新工艺/新产品的验证，获得客户批量重复订单； 2. 持续拓展 ALD 金属及金属化合物薄膜工艺开发，完成多款先进工艺设备出货。
沟槽填充系列产品	1. 持续提升 SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 的量产规模，获得重复订单。
三维集成领域系列产品	1. 推进新一代晶圆对晶圆混合键合设备、晶圆对晶圆熔融键合设备及芯片对晶圆混合键合设备的验证； 2. 完成新产品激光晶圆剥离设备出货。

（二）深化知识产权管理，奠定创新基础

公司经过十余年创新发展，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，并达到国际先进水平。2024 年，公司持续完善知识产权管理体系，面向公司产品全生命周期各关键节点进行专利挖掘布局，保证技术研发和创新成果及时、高效地获得知识产权保护。2024 年，公司新增申请专利 435 项（含 PCT）、新增获得专利 157 项。截至 2024 年末，公司累计申请专利 1,640 项（含 PCT）、获得专利 507 项，其中发明专利 246 项。预计 2025 年申请专利超过 400 项，为公司持续自主创新奠定基础。

（三）优化激励机制，加强研发团队建设

公司持续扩大研发人员规模，截至 2024 年末，公司研发人员达到 648 人，占公司员工总数的 42.30%。公司持续优化研发人员的创新激励机制，从短期、中期、长期等不同维度进行激励，并对获得专利、商标、软著、著作权等的发明人及团队给予“最佳专利奖”“专利先进个人奖”等创新类激励奖项，此外，结合重点项目、新产品、新工艺开发的完成情况为研发人员给予多项专项业务类奖项。此外，公司将通过实施股权激励、绩效奖金等一系列激励举措，继续加大力度，调动员工工作的积极性与创造性，促进公司研发技术团队的稳定性。2025 年，公司将进一步扩大研发人员规模，并持续完善、构建多维度的激励体系，充分激发团队活力，强化公司可持续创新能力。

三、重视股东回报，共享高质量发展成果

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值，积极采取以下措施：

（一）持续现金分红，提升投资者获得感

公司继续积极采取现金分红的方式分配股利，使投资者与公司共享发展成果。2024 年度，公司实施了 2023 年度现金分红，合计派发现金红利 6,572.1678 万元（含税）。

2025 年，公司将依据《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）继续实施 2024 年度现金分红，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），根据目前股本情况测算，预计派发现金红利 7,518.4530 万元（含税），该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）实施股份回购，增强投资者信心

2024 年，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司完成了首次股份回购计划，以集中竞价交易方式回购公司股份 1,267,894 股，成交总金额为 19,727.29 万元（含交易佣金等交易费用）。2025 年，公司将结合市场情况、公司股本结构及业务经营发展需求，适时实施股份回购或增持。

（三）积极稳定股价，保障股东权益

2024 年，公司基于已建立的稳定股价措施的方案积极维护公司市值，同时，公司密切关注媒体报道、资本市场的动态讯息，监测日常舆情情况，未发生重大舆情及股价异动。公司制定了《舆情管理制度》，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益。

2025 年，公司制定了《市值管理制度》，在聚焦主业的同时，适时通过开展资本运作、股权激励计划等方式，增强投资者信心，维护市值稳定。公司将积

极引入长期耐心资本，增强公司股本结构的稳定性，并通过监控各类舆情情况，如有发生，及时妥善处理，保障投资者利益。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露及投资者交流工作。2024年度，公司继续严格按照相关法律法规及监管要求，认真履行公司信息披露义务，强化了公司信息披露的质量和透明度。在披露定期报告、季度报告的同时，采用可视化的视频/图表、动态效果方式解读公司重大成果和进展，并在公司公众号发布，使投资者能清晰、及时、充分、公平地了解公司情况，公司在上海证券交易所2023-2024年度信息披露工作评价中获得“A”级。在投资者关系方面，2024年度，公司通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办了7次业绩说明会/投资者交流会，并设立了专业、专职的投资者关系管理人员，积极参加线上、线下的投资者交流会，与投资者交流次数超过180次，包括接待投资者现场调研、电话交流以及参加券商策略会、反路演等多种形式，积极加强与投资者的互动与沟通，增进投资者对公司的了解与信任。

2025年，公司将继续严格依照上市公司信息披露的相关法律法规和公司内部制度的要求，真实、准确、及时和完整的披露公司的定期报告、临时公告，保证投资者及时获取公司经营等方面的重要信息，并积极通过新媒体等多种形式向投资者展现公司的经营业绩、研发成果等重大信息；在投资者关系管理方面，公司将继续加强投资者关系管理工作，拟组织不少于7次业绩说明会/投资者交流会，邀请投资者走进上市公司，到公司实地参观，并积极与投资者交流，增进投资者对公司的了解，树立良好的资本市场形象。

五、坚持规范运作，强化公司治理

公司不断健全优化治理结构和内部控制体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

（一）完善治理制度，加强风险防范

2024年，公司依据相关法律法规修订和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易

管理制度》等治理制度和细则，促进公司的规范运作。同时，公司结合实际情况，不断完善公司内控建设，新增/完善多项内部管理制度，强化风险防范，确保公司合规、稳健运营。

2025年，公司依据相关法律法规制定了《市值管理制度》，后续将根据最新监管规则，及时修订公司治理制度和细则，持续深化内部控制体系建设，确保公司的规范运作和风险管控。

（二）强化“关键少数”责任，提升履职能力

2024年度，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员勤勉尽责，均亲自出席公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会，并参加了“上市公司董事、监事和高管初任培训”、“ESG与价值创造资本市场专题培训”、“独立董事后续培训”、“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议专题培训”、“董事会秘书后续培训”等监管机构组织的专项培训，积极学习最新的法律法规及相关政策，增强董监高合规意识和履职能力。同时，公司与董监高保持良好的、及时的互动沟通，并为独立董事履职提供便利条件，及时反馈公司经营过程中的重大事项，并传递资本市场监管部门的相关案例，切实推动公司高质量发展。

公司高度重视“关键少数”的合规交易和内幕信息知情人管理工作。2024年，公司认真梳理董监高及核心技术人员相关的股票交易规则，并结合公司实际情况对董监高进行讲解培训，强化其合规意识。在实施减持交易过程中，公司积极督促相关人员履行信息披露义务，并密切跟踪监测股票交易情况，确保每一笔交易及时在监管系统报备，全方位保障股票交易的合规性。此外，公司严格按照相关规则做好内幕信息知情人登记及防范内幕交易工作，及时提示董监高作出内幕信息知情期间禁止交易的提示，敦促其严格履行信息保密义务和股票买卖规定。

2025年，公司将继续保持对董监高等“关键少数”履职能力提升的重视，积极参加监管机构举办的相关培训，不断提升其履职能力。同时注重与“关键少数”管理人员的沟通交流，并继续加强合规交易和内幕信息管理，确保公司合规运营。

（三）构建 ESG 体系，促进可持续发展

公司作为高端半导体设备领域的领军企业，高度重视在环境、社会和公司治理（ESG）方面的建设，积极构建高效协同全员参与的 ESG 治理体系，将 ESG 的关键绩效指标融入公司的发展战略和实际经营活动中。目前公司搭建了由董事会全面主导决策、管理层统筹协调、执行层具体实施的三层 ESG 体系架构，高效推进 ESG 专项工作。

公司披露了第三份 ESG 报告（详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》），通过深入分析国家政策、国际 ESG 标准、上海证券交易所 ESG 指引和行业发展需求等内容，结合企业实际情况和战略规划，识别对公司和利益相关方具有重要意义的议题，并通过持续加强公司自身 ESG 和可持续发展能力建设，积极回应利益相关方的期望与诉求。

2025 年，公司将不断优化可持续发展工作机制，以更加科学化、专业化、体系化的方式推进 ESG 治理，助力公司高质量稳健发展。

六、持续评估完善行动方案，助力公司提质增效

公司将定期评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过深耕主业、高效运营、自主创新、规范治理等有效途径提高公司发展质量，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司的良好市场形象，助力公司在资本市场实现可持续发展。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日